



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图 赖谊成
审阅 罗云龙

核准 林钟涛

DIP28
(600MIL)

文件名称:
HG-DIP28 (600MIL)

文件编号:
HGWXT-230047

版本 V1.0

比例 1:1

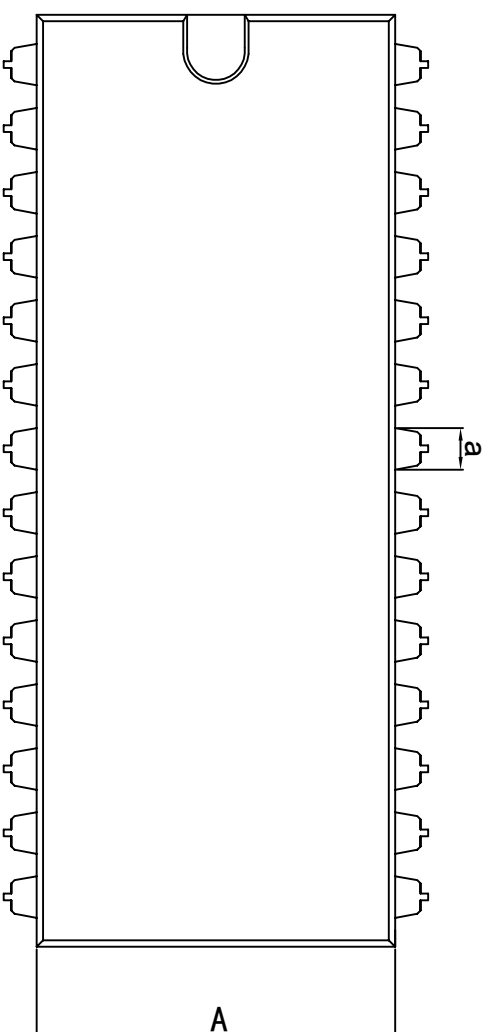
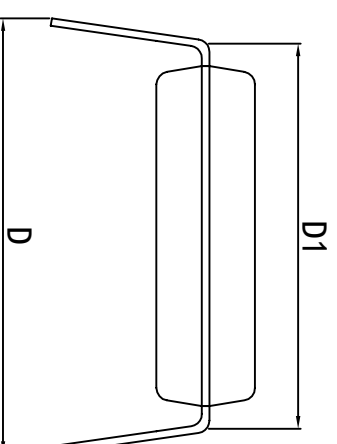
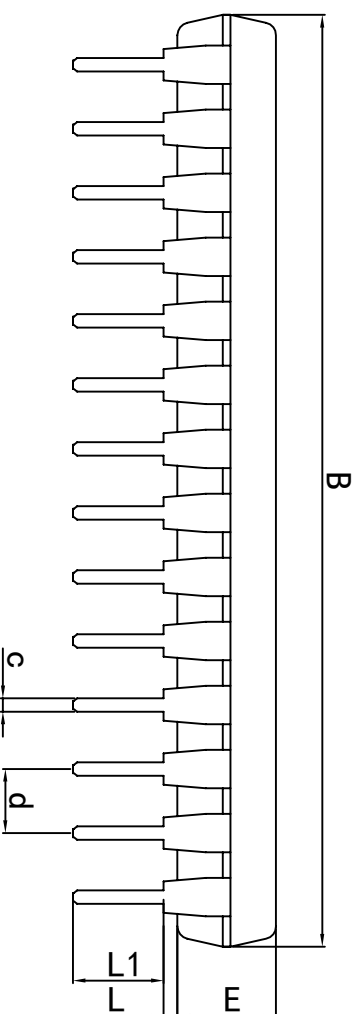
单位 mm

日期 2023-6-30

图纸幅面 A4



第一角法



UNITT: mm

DIM.	A	B	D	D1	E	L	L1	a	C	d
MIN	13.21	36.70	16.00	14.99	3.71	0.38	3.00	1.45	0.38	2.54
MAX	14.22	36.96	17.28	15.49	3.91	0.55	3.60	1.65	0.53	BSC